



鴻海iPEBG 2024

全球招募預辦航「海」計畫開跑！

鴻海科技集團是《財富》全球 500 強(2022 年高居第 20 位)，是全球最大的電子產業科技製造服務商，同時也是中國最大的出口創匯企業，集團專業從事 6C 產業、新能源、新材料等研發製造，近年來集團更積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「三加三」結合作為集團重要的長期發展策略，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。
iPEBG 創新機構事業群為鴻海科技集團世界級移動終端智能製造服務商，事業群不斷致力於科技創新、數字化與智能化全球佈局，專精高端 iPhone 製造技術研發、自動化、機器人及智能化解決方案，擁有高精尖製程工藝、關鍵設備開發能力、工業互聯網及人工智能技術研發與全球多場域落地應用。

世界級舞台，一流的客戶和優質的同事，歡迎追求卓越的優秀人才加入！

聯繫方式

聯絡電話：(02)2268-3466 轉 56871724 HR Sylvia

LinkedIn連繫方式：

HR Sylvia



HR Sam



電子郵件：fii-ipebg-shr-talentacquisition@mail.foxconn.com

地 址：新北市土城區中央路四段53號

iPEBG LINE群組



應徵流程：[鴻海科技集團官網](#) (註冊及維護履歷) > 點選表列iPEBG職位名稱連結 > 點選我要應徵

一、招募需求：(學士/碩士/博士，職位以實際需求為準)

職務類別：產品設計開發&製程

職位名稱	工作內容	科系要求
<u>機械設計工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 專案設計與展開、報告與製作 ■ 規劃與串接上下游製程 ■ 主導專案規格與樣品產出 ■ 主導新製程應用與導入 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 應力 ✓ 航太 ✓ 工程科學
<u>自動化機構開發工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 大型連線自動化設備機構方案規劃和技術指導 ■ 點膠雷射&貼膜組立等自動化設備機構方案評估及結構設計 ■ 點膠雷射及貼膜組立等設備的核心工藝實驗，驗證及可行性報告產出 ■ 現場設備的調試優化改善及異常處理 ■ 機構標準化文件的制定與發行 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 自動化工程 ✓ 應力 ✓ 航太 ✓ 工程科學
<u>自動化電控開發工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 設備控制系統軟體需求分析工作 ■ 運動控制方案軟體框架搭建與開發 ■ 專案前期參與軟體需求分析 ■ 設備控制系統軟件功能測試、現場設備重大問題調試等各種技術支持工作 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 自動化工程 ✓ 應力 ✓ 航太 ✓ 工程科學
<u>品質工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 承接客戶品質相關需求 ■ 與客戶制定品質檢驗規範及方法 ■ 與客戶例會，匯報良率及MIL 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 工業工程 ✓ 工程科學
<u>物理/化學沉積薄膜工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 負責顏色開發專案，應用於裝飾鍍製程 ■ 開發功能性、DLC等鍍膜製程 ■ ALD、CVD製程開發及機台導入 ■ 鍍膜機台改裝與設計提供開發專案所需的硬體提升 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 應力 ✓ 材料工程 ✓ 工程科學
<u>設備工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 螢幕撕/貼膜類自動化設備維護 ■ 螢幕組件精密貼合自動化設備維護 ■ 螢幕低壓注膠成型自動化 ■ 點膠類自動化設備維護 ■ 雷射焊接與檢測多功能模組連線自動化維護 ■ 尺寸檢測自動化設備維護 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 機電工程 ✓ 應力 ✓ 航太 ✓ 工程科學
<u>IE工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ FLC架構及規範制定，FLC規劃及合理性分析、發行 ■ 開發製程、治具、包材設計合理化評估及作業改善推動 ■ FLC差異分析，量產資源、成本風險預警 ■ 自動化開發標準流程制定及開發時程規劃、立項規劃、量產規劃 ■ 自動化開發進度統籌管控及風險預警 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 工業工程 ✓ 工業管理
<u>新材料開發工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計複材穿載裝置與移動裝置 ■ 依據產品做材料選型 ■ 複材製程拆解與失效分析 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 材料工程 ✓ 化學工程 ✓ 化學相關
<u>高分子研發工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建立模流分析技術(Moldex3D、Ansys)-透析灌膠成型產品的微結構 ■ 膠水特殊功能的開發-提升膠水在灌膠工藝上的實用性 ■ 新成型技術開發-研發快速成型技術及輕量化高耐用新型模具材料開發 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 高分子 ✓ 材料工程 ✓ 化學工程 ✓ 化學相關
<u>雷射光學開發工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 雷射製程開發 ■ 量試異常解決 ■ 各地量導協助 ■ 自動化開發 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 光電工程 ✓ 機械工程 ✓ 應力
<u>失效分析工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 材料結構與特性分析 ■ 工程失效分析支援產品開發 ■ 檢測技術開發與導入 ■ 材料測試數據分析與報告撰寫 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 化學工程 ✓ 材料工程 ✓ 機械工程
<u>AI算法工程師</u>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 配合智能分析平台(Linux系統)，算法模型環境佈署與建 ■ Linux 開發作業環境建置，自研程式與開源算法編譯 ■ 協助算法模型封裝，虛擬化(docker)管控 ■ 智能模組與前端通訊模組資料交互反饋 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 機械工程 ✓ 資訊工程 ✓ 數學相關